

# 深圳摄像头模组的胶水哪家优惠

生成日期: 2025-10-25

低温黑胶的胶接是通过具有黏附能力的物质,把同种或不同种材料牢固地连接在起的方法。具有黏附能力的物质称为胶粘剂或黏合剂,被胶接的物体称为被粘物,胶粘剂和被黏物构成的组件称为胶接接头。其主要优点是操作简单、生产率高;工艺灵活、快速、简便;接头可靠、牢固、美观产品结构和加工工艺简单;省材、省力、成本低、变形小。容易实现修旧利废接技术可以有效地应用于不同种类的金属或非金属之间的联接等。现在使用的胶粘剂均是采用多种组分合成树脂胶粘剂,单一组分的胶粘剂已不能满足使用中的要求。已经开封但没有用完的低温环氧胶,要密封盖好,放回冰柜储存,下次优先使用。深圳摄像头模组的胶水哪家优惠

低温黑胶在使用前必须将其恢复到室温,在恢复到室温以前请不要打开包装(建议回温至少 1 小时)。建议(0.15—0.35Mpa)点胶压力,使用针头点胶速度(4—10mm/s)。本品在(25℃)的条件下,适用期是 72h。(建议回温次数小于三次)未使用完的胶,请先放入塑料袋内密封后再放入冰箱储存。

- 1、低温环氧胶使用时,为达到更好的使用效果,请去除粘接材料表面的油污。
- 2、该产品每次应适量挤出,以避免造成浪费。
- 3、施胶完毕后,尽快用于粘接的基材表面。在粘接过程中,保证粘接部位之间不要有相对位移,以获得有效的粘接强度。
- 4、多余的未固化的胶,为防止污染部件,建议在固化前清理。
- 5、当温度的后固化可以较大程度提高粘合剂的交联密度从而获得较佳的粘接性能。深圳摄像头模组的胶水哪家优惠低温黑胶在高温环境下,保存期会严重缩短。

低温环氧树脂胶是一种单组份、改性环氧树脂胶,用于BGA或CSP底部填充制程。它能形成一致和无缺陷的底部填充层,能有效降低由于硅芯片与基板之间的总体温度收缩特性不匹配或外力造成的冲击。受热时能疾速固化。较低的粘度特性使得其能更好的进行底部填充;较高的活动性增强了其返修的可操作性。

修复顺序:

1. 将CSP/BGA包的底部和顶部位置先预热1分钟,加热到200-300℃时,焊料开端熔化移除边缘已固化的底部填充胶,拿出CSP/BGA
2. 抽入空气除去PCB底层的已熔化的焊料碎细。
3. 将PCB板移到80-120℃的盘子上,用刮刀除掉固化的树脂胶残留物。
4. 假如需要,用酒精清洗修复面再修复一次。

注意:较理想的修复时间是在3分钟以内,因为PCB板在低温下放置太久能够受损。

单组份环氧胶。该胶水非常适合于电子元器件的灌封应用。它具有非常好的耐化学性能,可以耐油脂、汽油等,是汽车和航空等工业粘接应用好的选择。已经成功应用于一些需要高度耐热煤油和制动液的应用中。由于其剪切变稀的性能,流淌性控制及在元器件表面精确点胶的能力得到了改善。该胶水对陶瓷、金属以及很多塑料都有很好的粘接力。黑胶可以在低温下迅速固化。100℃条件下该胶水可以在几分钟内完全固化。在铁磁物质上可以通过电磁感应进行固化。低温黑胶施胶完毕后,尽快用于粘接的基材表面。

提高环氧胶固化速度的几种方法:环氧胶在一定温度范围内加温处理,可以有效提高胶水的固化速度。温度越高,固化速度越快。如:双组份环氧胶,常温下24小时完全固化,但是在75℃环境下,1小时即可完全固

化。针对单组份环氧胶可以先将物料调配好，稍微等一段时间再使用，等胶量有了反应再去浇注，这样能够加快固化。在一定范围内，提高环氧胶固化剂的用量，能有效提高胶水固化速度。胶水点胶量要合适，环氧胶一次性施胶太多，自然需要更长时间才能完全固化，施胶太少，虽然胶水固化速度快了，但是达不到粘接要求，影响胶水的粘接效果。低温黑胶运输过程中所有的运输想内需放置冰冷袋以维持温度在8℃以下。深圳摄像头模组的胶水哪家优惠

低温黑胶的固化时间从几分钟到几个小时不等。深圳摄像头模组的胶水哪家优惠

低温黑胶吸引人之处能够是它适用于多种不同的工艺条件。这种材料在120℃ 时即可固化，因此温度敏感器件制造商可以享用其弱小功用而不会造成器件损伤。另一方面，即使 有工艺要求较低温度，可在150℃下固化。依据制造办法的不同，也可在其它加热工序的进程中固化，从而提高产量。另外，用该材料替代热脂或相变材料，无需使用夹子或螺钉固定器件，既降低了本钱，又浪费了时间。提供了散热组件和发热器件之间的机械强度，满足低热阻和绝缘要求。深圳摄像头模组的胶水哪家优惠